



GLPOLY XK-PN60 非硅导热垫片

产品简介	产品特性	典型应用
非硅导热垫片是特殊树脂为基材的非硅导热材料，因材料没有低分子硅氧烷挥发，不会造成电子器件污染短路，且具有很好的拉伸强度和耐磨性，提供更高的变形量与更高的导热率。	高导热系数6.0 W/mk 无硅氧烷小分子挥发 高绝缘性、高压缩性 双面粘性、易操作	光学精密设备 高端工控及医疗电子等领域 笔记本电脑，硬盘 移动及通讯设备 汽车发动机控制设备 动力电池包 车载导航仪

主要性能

	单位	XK-PN60	测试法
补强材		/	
固有表面粘性(单双面)		双面	
颜色		灰色	目测
厚度	mm	0.5-5	ASTM D374
密度	g/cm ³	3.3	ASTM D792
硬度	Shore 00	55-80	ASTM D2240
热阻 @0.5mm 30psi	°Cin ² /W	0.13	ASTM D5470
导热系数	W/mk	6.0	ASTM D5470
体积电阻	Ωcm	>10 ¹³	ASTM D257
击穿强度	KV/mm	10	ASTM D149
介电常数	1	8	ASTM D150
工作温度	°C	-60~135	ASTM G166
拉伸强度	psi	>10	ASTM D412
伸长率	%	20	ASTM D412
硅氧烷 D4~D20	%	0	GC-MS
阻燃性	UL94	V-0	UL94
贮存时间	Months	12	UL 746B, Viscosity method

特别声明：

以上所有陈述，技术信息和建议均基于本公司认为可靠的测试或经验。鉴于配方、工艺、时间、条件等的不同，许多不可控因素都可能影响产品在特定应用中的使用和性能，因此用户应做评估并根据自己的生产情况进行调整，我司不作出任何承诺。我们强烈建议您进行自己的测试试验，以确认我们产品的适用性。敝司有权对自己的产品进行改进升级，其产品有任何改动，按技术状态管理程序提前通知。

除非另有明确约定，否则对技术数据表中的信息或有关产品的任何其他书面或口头建议不承担任何责任。

